



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20130326000

2013 年 3 月 28 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA .35um-UMC-F8J プロセス 一部製品 前処理サイト変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☒ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐	-
変更内容	HPA . 35um-UMC-F8Jプロセス 一部製品 前処理サイト変更 現行 : UMC-F8J社(日本) 変更後 : UMC-F8E社(台湾)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	7月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	-			

変更内容

内容: 弊社 HPA(ハイパフォーマンシアナログ) . 35um-UMC-F8Jプロセス 一部製品の前処理サイトについて、現行 UMC-F8J社(日本)サイトにて製造いたしておりますが、サイト閉鎖による供給能力確保の為に、これに替えて、UMC-F8E社(台湾)サイトに変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

前処理サイト
プロセス
ウェーハ径

現行

UMC-F8J社(日本)
. 35um-UMC-F8J プロセス
200 mm

変更後

UMC-F8E社(台湾)
0. 35 DPQM プロセス
200 mm

理由: サイト閉鎖による供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
PCM1606E	PCM1742E/2K	PCM1748E/2KG4	PCM1753DBQRG4	PCM1755DBQ
PCM1606E/2K	PCM1742E/2KG4	PCM1748EG4	PCM1753DBQR-S2	PCM1755DBQG4
PCM1606E/2KG4	PCM1742EG4	PCM1748KE	PCM1753DBQR-S2G4	PCM1755DBQR
PCM1606EG	PCM1742KE	PCM1748KE/2K	PCM1754DBQ	PCM1755DBQR/2354
PCM1606EG/2K	PCM1742KE/2K	PCM1748KE/2KG4	PCM1754DBQG4	PCM1755DBQRG4
PCM1606EG/2KE6	PCM1742KE/2KG4	PCM1748KEG4	PCM1754DBQ-P	
PCM1606EG4	PCM1742KEG4	PCM1753DBQ	PCM1754DBQ-PG4	
PCM1606EGE6	PCM1748E	PCM1753DBQG4	PCM1754DBQR	
PCM1742E	PCM1748E/2K	PCM1753DBQR	PCM1754DBQRG4	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記のようになります。

	現行	変更後
Fab Site: 前処理サイト	UMC-F8J	UMC-F8E
CSO (20L): 前処理サイト記号	U8J	U8E
CCO (21L): 生産国記号	JPN	TWN



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2013 年 3 月	終了	2013 年 6 月末
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	PCM1753TDBQRQ1	-	-	
Wafer Fab Site:	UMC-F8E	Wafer Fab Process:	0.35 DPTM	
Wafer Diameter(mm):	200	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	140C, 480 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD CDM	250V	3	3	3
ESD HBM	1000V	3	3	3
Ball Bond Shear	76 balls, 3 units min	76	76	76
Bond Pull	76 Wire, 3 units min	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Latch-up	Per JESD78	6	6	6
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2013 年 3 月	終了	2013 年 6 月末
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	PCM3168ATPAPRQ1	-	-	
Wafer Fab Site:	UMC-F8E	Wafer Fab Process:	0.35 DPTM	
Wafer Diameter(mm):	200	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	125C, 1000 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Life	150C, 1000Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**Temp Cycle	-65C/150C, 500 Cycles	77	77	77
ESD CDM	250V	3	3	3
ESD HBM	1000V	3	3	3
Ball Bond Shear	76 balls, 3 units min	76	76	76
Bond Pull	76 Wire, 3 units min	76	76	76
Die Shear	-	10	10	10
Latch-up	Per JESD78	6	6	6
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				